

# formnext

forum TOKYO

フォームネクストフォーラム 東京 2024

2024年  
9月26日(木) - 27日(金)  
東京都立産業貿易センター 浜松町館 4F  
10:00 - 17:00

[www.formnextforum.jp](http://www.formnextforum.jp)

主催：メッセフランクフルト ジャパン株式会社  
協賛：一般社団法人日本AM協会  
(順不同) 一般社団法人日本自動車部品工業会  
一般社団法人日本3Dプリンティング産業技術協会  
AM (Additive Manufacturing) 研究会

来場のご案内

3Dプリンティングなどの  
アディティブマニファクチャリング技術、  
その関連技術、製品、サービス、情報が集まる、  
展示とセミナーの複合イベント

messe frankfurt

来場  
事前登録制

ご入場いただくには「来場事前登録」が必須です。公式ウェブサイトより「来場事前登録」を行ってください。  
来場事前登録を行わずに、本「来場のご案内」をお持ちいただいてもご入場いただけません。



[www.formnextforum.jp](http://www.formnextforum.jp) ▶ 来場事前登録



## 主催者特別セミナー

業界の著名人による必見のセミナー

事前申込制

無料

会場：4F会議室3 (定員約100名)

9月26日(木)	11:00	11:00	海外でのAM活用事例とAMノウハウの活用方法について
	12:00	12:00	挨拶 経済産業省 製造産業局 素形材産業室 室長補佐 米原 牧子 講演 オリックス・レンテック株式会社 事業戦略本部 事業開発部 副部长 袴田 友昭
	12:30	12:30	セラミックス3D積層造形の現状と今後の展望
	13:30	13:30	豊橋技術科学大学 総合教育院(電気電子情報工学系 兼務) 教授 武藤 浩行
	14:00	14:00	ものづくりによるコミュニケーション活性化と共創
15:00	15:00	ソニー株式会社 デザインエンジニア 福馬 洋平	
15:20	15:30	グローバルな視点で見たAM/3Dプリンティングの最新動向2024	
16:30	16:30	一般社団法人日本3Dプリンティング産業技術協会 常務理事・研究員 松岡 司	

主催者特別セミナー  
聴講申込方法



主催者特別セミナーへの参加には聴講申込が必要です。

QRコードを讀取り、各セミナーごとお申込みください。申込後に送信される「聴講申込完了通知メール」を当日各セミナー受付にてご提示ください。

[www.formnextforum.jp](http://www.formnextforum.jp) ▶ イベント・企画・セミナー

- ※ 完了通知メールが届かない場合は、事務局までご連絡ください。
- ※ 展示会場へのご来場については別途「来場事前登録」が必要となります。
- ※ 「聴講申込完了通知メール」は整理券ではございません。
- ※ 満席となり次第、申込受付を締切させていただきます。
- ※ 残席がある場合は当日会場にて聴講を受け付けます。

## 業界団体セミナー

セミナー受付で名刺を1枚お渡しください

事前申込不要

無料

会場：展示場内セミナーエリア (定員約60名)



生活に広がる3Dプリンティング2024

主催 一般社団法人日本3Dプリンティング産業技術協会

9月26日(木)	13:45-13:55	挨拶・オリエンテーション	一般社団法人日本3Dプリンティング産業技術協会 代表理事 三森 幸治/常務理事・研究員 松岡 司
	13:55-14:35	リマニファクチャリングと3Dプリンティングへの期待	国立研究開発法人産業技術総合研究所 製造技術研究部門 松本 光崇
	14:35-15:15	FoodTech をリードする「3Dフードプリンター」の「今」と「未来」	ミツイワ株式会社 ファクトリーイノベーション推進部 シニアマネージャー 本多 隆史
	15:15-16:05	建設向け3Dプリンタがもたらすものづくりの未来	清水建設株式会社 技術研究所 主任研究員 小倉 大季
	16:05-16:45	折紙に着想を得たコンピューショナル・ファブリケーション	慶應義塾大学 理工学部情報工学科 准教授 鳴海 紘也



9月27日(金) 12:45-13:45 レーザー粉末床溶融方式(L-PBF)による水アトマイズ粉末の造形

主催 兵庫県立大学金属新素材研究センター

兵庫県立大学金属新素材研究センター 柳谷 彰彦

## AM研究会 産官学連携によるオールジャパンのAM研究開発体制の構築とその未来

主催 AM (Additive Manufacturing) 研究会

9月27日(金)	14:00-14:15	AM研究会のご紹介と日本AM学会の設立に向けて	大阪大学大学院工学研究科 教授 中野 貴由
	14:15-14:45	素形材産業を巡る動向とAM技術の普及へ向けて	経済産業省 製造産業局 素形材産業室 室長補佐 米原 牧子
	14:45-15:05	三菱重工業におけるAM適用事例の紹介 ~ガスタービンへの適用事例	三菱重工業株式会社 エナジードメイン GTCC事業部 事業部長代理 片岡 正人
	15:05-15:25	AMを活用した整形外科用インプラントの研究開発から製品化に至る事例紹介	帝人ナカシマメディカル株式会社 取締役会長 中島 義雄
	15:25-15:45	NIMSのAMチャレンジ：最前線の研究開発事例	国立研究開発法人物質・材料研究機構 構造材料研究センター 副センター長 渡邊 誠
	15:45-16:05	大陽日酸における先進的金属AM技術に関する産学共同研究開発例のご紹介	大陽日酸株式会社 イノベーションユニット イノベーション事業部 AMイノベーションセンター 所長 尾山 朋宏
	16:05-16:25	AM用金属粉末の技術開発	山陽特殊製鋼株式会社 取締役常務執行役員 柳本 勝
	16:25-16:30	閉会のご挨拶	大阪大学大学院工学研究科 教授 安田 弘行

※敬称略・各セミナーのタイトル、講演内容、座席数は変更になる場合がございます。

# 出展ブースエリア


## 出展者一覧 (2024年7月22日現在) └ は共同出展 (五十音順)

愛知産業 (株)	ティーケーエンジニアリング (株)	ホッティーポリマー (株)
旭化成 (株)	(株) ニコン	マテリアライズジャパン (株)
EOS Electro Optical Systems Japan (株)	日本製紙 (株)	三菱ケミカル (株)
伊藤忠テクノソリューションズ (株)	(一社) 日本AM協会	三菱電機 (株)
└ QuesTek Japan (株)	└ 応用技術 (株)	森村商事 (株)
イントリックス (株)	└ ジェビーエムエンジニアリング (株)	UEL (株)
SCSK (株)	└ 日本ミシュランタイヤ (株)	(株) YOKOITO
カーペンターアディティブ ジャパン (株) 久宝金属製作所	└ パルステック工業 (株)	Constellium Technology Center (フランス)
(株) クリモト	└ 三井化学 (株)	HDC Co., Ltd. (大韓民国)
コアフロント (株)	日本電子 (株)	Intech Additive Solutions Pvt. Ltd (インド)
GFマシニングソリューションズ (株)	(一社) 日本3Dプリンティング産業技術協会	Wuhu R3D Technology Co., Ltd. (中国)
シーフォース (株)	└ VISITECH JAPAN	
ShareLab (シェアラボ)	└ ミツイワ (株)	
JFEエンジニアリング (株)	ひょうごメタルベルトコンソーシアム (兵庫県立大学)	
シモダフレンジ (株)	(株) エスケーフライン	
新東Vセラックス (株)	└ 金属技研 (株)	
第一セラム (株)	(株) 神戸工業試験場	
大陽日酸 (株)	└ 大亜真空 (株)	
(同) DMM.com	└ ニイム産業 (株)	
DMG森精機 (株)	└ 兵庫県立工業技術センター	
	ブィデーエム メタルズ ジャパン (株)	

- ### 出展製品
- 造形ソリューション
  - 素材・材料
  - 製造準備・前加工
  - 部品加工・表面加工ソリューション・後加工
  - 受託製造サービス・デザイン・製品開発
  - 工具・金型
  - ソフトウェア
  - 品質管理・計測
  - 認証・規格
  - 研究開発
  - 団体・出版
  - その他

- ### 来場対象
- AM関連装置・機器
  - 自動車・航空・宇宙
  - エレクトロニクス・半導体
  - 電気・電子機器・総合機器
  - 精密機器・産業機器・ロボット
  - 食品・医薬品
  - 衣料・日用品・宝飾品
  - 加工(含委託加工)・印刷・検査
  - 素材・材料・化学
  - 鉄道・造船・輸送
  - 建設・建築・不動産・インフラ
  - 電力・エネルギー
  - 機械工学・プラントエンジニアリング
  - ヘルスケア・デンタル技術・医療技術
  - ソフトウェア・通信・ネットワーク
  - 商社・代理店・小売業・リース業・オフショア
  - 官公庁・協会団体・大使館
  - 研究機関・大学・学生
  - その他

**最新情報をチェック!**  
 便利な出展者検索をご利用ください



## 出展者プレゼンテーション 各セッション受付で名刺を1枚お渡しください 事前申込不要 無料 会場：展示場内セミナーエリア(定員約60名)

出展者による自社製品・サービスのプレゼンテーション ※敬称略・各セミナーのタイトル、講演内容、座席数は変更になる場合がございます。

9月26日(木)	10:30-11:00	DMG森精機のAM最新技術及びAM量産部品のご紹介	DMG森精機株式会社 萩森 紗季
	11:15-11:45	Magics 最新版と業界連携の最前線	マテリアライズジャパン株式会社 小林 毅
	12:00-12:30	3DP材料(フィラメント「サイロン、サーミレン」とマーケティング展望のご紹介	旭化成株式会社 3DP事業開発室 猿川 浩史/中島 正希
9月27日(金)	12:45-13:15	冷却用構造設計支援CAE~ユーザー適用事例紹介	SCSK株式会社 デジタルエンジニアリング事業本部 プロダクト技術部 佐藤 充
	10:30-11:00	EOSグループからの最新情報	EOS Electro Optical Systems Japan株式会社 橋爪 康晃
	11:15-11:45	樹脂AMが実現する開発と製造の統合 ~最終製品事例とそのインパクト~	株式会社YOKOITO 中島 佑太郎/株式会社アザース 大貫 泰成
	12:00-12:30	Dyndrite社による革新的AM用ソフトウェアのご紹介	愛知産業株式会社 日比 裕基

## 会場へのアクセス アクセスに関する最新情報

**東京都立産業貿易センター浜松町館**  
 東京都港区海岸1-7-1

- JR, 東京モノレール 浜松町駅(北口) から 約350m 徒歩5分
- ゆりかもめ(新交通) 竹芝駅から 約100m 徒歩2分
- 浅草線, 大江戸線(都営地下鉄) 大門駅から 約450m 徒歩7分



画像提供: 東京都立産業貿易センター 浜松町館

## 来場に関し ご来場には「来場事前登録」が必須です。

以下の2通りの方法から来場登録をお願いいたします

### 1. スマートフォンでのご登録

右記QRコードを読み取り、事前登録のご案内をご参照のうえ、「来場事前登録」を行ってください。

事前登録後、入場に必要なおQRコードが発行されます。

ご来場の際は、会場にて事前登録ページにログインしていただき、このQRコードにて来場者バッジの発行を行います。

### 2. PCでのご登録

下記URLから、事前登録のご案内をご参照いただき、「来場事前登録」を行ってください。

[www.formnextforum.jp](http://www.formnextforum.jp) ▶ 来場事前登録

事前登録ページにログインしていただき、「自分で来場者バッジを印刷」を押して、プリントアウトを会場にお持ちください。受付登録不要となります。

来場者バッジを事前に印刷することができます。

**⚠ 本ご案内状をご持参いただくだけでは、展示場内に入場できません。事前登録を済ませたうえで会場にお越しください**

**【来場に関する注意事項】** 本イベントはビジネス商談展示会です。業界関係者以外のご入場および、15歳未満、ベントをお連れの方のご入場はお断りいたします。暴力団、暴力団関係団体およびその関係者、もしくはその他反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらの反社会的勢力を利用していることが判明したときは、来場をお断りいたします。

**【個人情報の取扱いについて】** ご登録いただきました個人情報は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランクフルト グループ会社\*が主催・運営する国内外の見本市・イベント(含オンライン)のご紹介および出展者、各種サービスや関連情報、共催者・出展者・スポンサー等の製品やサービスに関する情報をご提供するために利用させていただきます。これらの正当な目的以外に無断で利用することはありません。なお、ご登録いただきました個人情報は弊社にて厳重に管理いたします。また、弊社は上記の目的のために記載された情報をメッセフランクフルトグループ会社\*および協力会社に対し提供させていただく場合があります。弊社が、これらの情報を、メッセフランクフルトグループ会社\*および協力会社へ提供させていただく場合があることについて、同意していただきますようお願いいたします。

\*メッセフランクフルト グループ会社の定義については、当社ウェブサイト・プライバシーポリシー-<https://www.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/privacy-policy.html>をご覧ください。 個人情報に関するお問合せ窓口 E-mail: [privacy@japan.messefrankfurt.com](mailto:privacy@japan.messefrankfurt.com)

**【事務局による会場内記録の使用について】** 事務局はイベント会場内において取材・撮影を行います。取材によって得られた情報や撮影した画像は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランクフルトグループが主催・運営する国内外見本市・イベント(含オンライン)の広報・宣伝活動に使用される場合があります。

出展者名:  小間番号:

がご案内いたします。

メッセフランクフルト ジャパン株式会社 Formnext Forum Tokyo 事務局  
 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-8-19 住友不動産千代田富士見ビル4F  
 Tel. 03-3262-8456 Fax. 03-3262-8442  
 E-mail. [visit@formnextforum.jp](mailto:visit@formnextforum.jp)  
 Web. [www.formnextforum.jp](http://www.formnextforum.jp)

messe frankfurt

**Formnext Forum Tokyo2024 併催イベント**


パワーエレクトロニクスの世界最大級の見本市、PCIM主催者 Mesago Messe Frankfurt(ドイツ)による **業界セミナーおよびPCIMヨーロッパのご案内**

世界最大級のパワーエレクトロニクスの専門見本市「PCIMヨーロッパ」主催のメッセフランクフルトによる、業界セミナーを9月27日(金)にFormnext Forum Tokyo2024 会場内で開催いたします。

パワーエレクトロニクスは、エネルギーや環境問題への課題解決のキーテクノロジーとして近年注目が高まっており、今後成長が期待できる分野です。本セミナーでは、マーケットトレンドに加え、PCIMヨーロッパのご案内など、今後パワー半導体分野への参入やビジネス拡大を目指す方々へ必見のイベントです!

世界最大級の **パワーエレクトロニクス** 専門見本市

**PCIM EUROPE** セミナー

詳細・申込みはこちら 

**事前登録制・聴講無料**

**9月27日(金) 14:30 - 16:30(予定)**  
**浜松町館 会議室2**